



**eMEI Group**  
**依美集團**

先进

# 粘合材料

— 产品选择指南

依美聚合产品有限公司  
Emei Materials Systems Limited

沙田安平街6号新贸中心A座三楼五室  
Unit 5, 3/F, Block A New Trade Plaza, 6 On Ping Street, Shatin, NT, HK.  
Tel: +852-2428 7878 Fax: +852-2686 1192

东莞依美聚合产品有限公司  
Dongguan Emei Materials Systems Limited

广东省东莞市桥头镇桥新路8号 邮编: 523525  
No.8 Qiaoxin Road, Qiaotou, Dongguan, Guangdong, P.R. China  
Postal Code: 523525  
Tel: 86-769-8334 1628 Fax: 86-769-8334 2028

依美聚合材料(上海)有限公司  
Emei Materials Systems (Shanghai) Limited

中国上海自由贸易试验区美盛路111号第四层79部位  
4/F, 79 Parts, 111 Meisheng Road, F.T.Z., Pudong, Shanghai, China  
Tel: +86-21 5868 3381 Fax: +86-21 5868 3386

台湾仕来高电子制品股份有限公司  
Taiwan Schlegel Electronics Limited

新北市板桥区文化路二段182巷3弄99号 邮递编号: 220393  
No.99, Alley 3, Lane 182, Section 2, Wenhua Road, Banqiao District,  
New Taipei City, Taiwan R.O.C. Post Code: 220393  
Tel: +886-2-8258-5148 Fax: +886-2-8258-5149

Email: [ems@emeigroup.com](mailto:ems@emeigroup.com)

Disclaimer:  
EmeiGroup reserves the right to change product specifications without prior notice.  
User/buyer shall bear all losses or risks associated with the use of the products.  
In case of dispute, EmeiGroup has the right of final decision.

免责声明:  
依美集团保留更改产品资料和外观特性等的最终权力而无需事先通知, 对于使用产品上所  
面对的损失或风险, 用家、买家需自行承担。如有任何争议, 依美集团保留最终决定权。

©2024 EmeiGroup

**eMEI Group**  
**依美集團**  
[www.emeigroup.com](http://www.emeigroup.com)



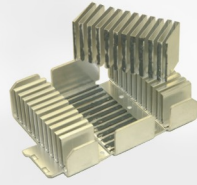
电子生产用 · 灌封 · 灌注 · 导电 · 粘合剂

[www.emeigroup.com](http://www.emeigroup.com)

## 导热材料 Thermal Management Material

### 主要应用

- 散热器装配
- 热传感器灌封
- 电子产品导热灌封



产品型号	描述	特性	粘度 cPs @25°C	固化条件
282A/B	双组份环氧(灰色)	2W/mK 高导热率、1:1 混合比、双管针筒包装、使用方便	糊状	25°C 24hrs 或 65°C 2hrs
284A/B	双组份环氧(黑色)	2W/mK 高导热率、1:1 混合比、双管针筒包装、使用方便	100K-150K	25°C 24hrs 或 65°C 2hrs
286A/B	双组份环氧(白色)	2W/mK 高导热率、1:1 混合比、双管针筒包装、使用方便	糊状	25°C 24hrs 或 65°C 2hrs
310-01	单组份环氧树脂	4.2W/mK 高导热率、高粘附力、黑色	200K-300K	150°C 30mins 或 125°C 60mins 或 reflow
310-01HF	单组份环氧树脂	无卤、4.2W/mK 高导热率、高粘附力、黑色	200K-300K	150°C 30mins 或 125°C 60mins 或 reflow
310-01GHF	单组份环氧树脂	无卤、4.2W/mK 高导热率、高粘附力、灰色	200K-300K	150°C 30mins 或 125°C 60mins 或 reflow
400-64-1AFR/600-9B	双组份环氧树脂	UL94V-0、2.5W/mK 高导热率、低CTE热膨胀系数	60K-90K(混合后)	25°C 16hrs 或 65°C 1hr
400-64-1AFR/601-23B	双组份环氧树脂	2.5W/mK 高导热率、低CTE热膨胀系数	60K-80K(混合后)	80°C 16hr 或 120°C 60mins
400-64-1AFR/Cat-Gel	双组份环氧树脂	2.5W/mK 高导热率、低硬度、低应力	20K-30K(混合后)	100°C 3hrs 或 125°C 2hrs
498-11A/B	双组份环氧树脂	2.4W/mK 高导热率、灰色、室温固化	10K-15K(混合后)	25°C 24hrs
498-12A/B	双组份环氧树脂	2.4W/mK 高导热率、高粘附力、脱泡性能佳	10K-15K(混合后)	25°C 24hrs 或 80°C 2hr
498-13A/B	双组份环氧树脂	4.7W/mK 超高导热率、高粘附力	20K-40K(混合后)	25°C 24hrs 或 80°C 2hr
318-9	散热膏(硅性)	4.5W/mK 超高导热率	膏状	--
505-61	散热膏(非硅性)	4.5W/mK 超高导热率	膏状	--
CAC104	散热膏(硅性)	0.8W/mK 高导热率	膏状	--
CAC105-LV	散热膏(非硅性)	0.8W/mK 高导热率	100K	--
CAC106	散热膏(硅性)	2.0W/mK 高导热率	膏状	--
E-fill 3300	双组份导热灌封硅胶	1.5W/mK 导热率、低价	6K-9K	80°C 15mins 或 25°C 8hrs
Lord CK-6037/6252	双组份环氧树脂灌封胶	低硬度、高导热性	20K-40K(混合后)	25°C 24hrs 或 65°C 2hrs

## 继电器封边 Relay Sealant

### 主要应用

- 继电器组装封边
- 继电器气孔封口
- 不含有机硅



产品型号	描述	特性	粘度 cPs @25°C	固化条件
380-03	单组份环氧树脂	亮光、一般应用	25K-35K	100°C 60mins
380-06	单组份环氧树脂	亮光、低有机物挥发	25K-35K	100°C 45mins
380-09	单组份环氧树脂	白色继电器封边胶	20K-27K	120°C 30mins
380-10	单组份环氧树脂	哑光、一般应用、低价	20K-27K	110°C 60mins
380-10(H81138)	单组份环氧树脂	半亮光、高粘力、快速固化	35K-45K	110°C 60mins
380-13A/B	双组份环氧树脂	快速室温固化、粘度较高	20K-30K(混合后)	25°C 135mins
380-14	单组份环氧树脂	棕色继电器封边胶	20K-27K	120°C 30mins
380-16	单组份环氧树脂	固化后透明	15K-25K	110°C 60mins
400-30	单组份环氧树脂	哑光、广泛应用在继电器封装	20K-27K	120°C 30mins
400-30D	单组份环氧树脂	适合自动点胶、粘度较高	25K-35K	120°C 30mins
716-02A/B	双组份环氧树脂	拨码开关底部填充灌封胶、快速固化	4K-5K(混合后)	120°C 10mins 或 25°C 24hr
RS-1128	单组份环氧树脂	亮光、低温固化	70K-90K	90°C 90mins
RS-1132	单组份环氧树脂	半亮光、对塑胶基材附着力高	40K-55K	120°C 30mins
RS-1133	单组份环氧树脂	防爆继电器用	55K-70K	120°C 30mins
RS-1138	单组份环氧树脂	哑光、一般应用、低价	20K-27K	110°C 60mins
RS-1152	单组份环氧树脂	低温固化继电器封边胶	55K-65K	90°C 30mins
RS-1158	单组份环氧树脂	低温固化继电器封边胶	50K-60K	80°C 30mins
RS-1168	单组份环氧树脂	半亮光/高粘力/快速固化	20K-35K	110°C 60mins
SUA-30T	紫外光固化封气孔胶	快速UV固化	4K-7K	1000mJ/cm <sup>2</sup>

## 半导体封装应用 Semiconductor Application

### 主要应用

- 高功率LED晶片粘接
- UV固化透明盖封保护胶
- 一般LED晶片粘接
- 电源部分导热灌封



产品型号	描述	特性	粘度 cPs @25°C	固化条件
CA-188-2	单组份银胶	高导电率、低温固化	15K-20K	80°C 30mins
CA-272	单组份银胶	高导电率、瞬间固化	20K-25K	150°C 30sec
DA-5990	高功率芯片粘接银胶	20W/mK高导热率、快速固化	12K	150°C 30mins
DA-5991-1	高功率芯片粘接银胶	25W/mK超高导热率、良好导电性	11.5K	150°C 30mins
DA-592	高功率芯片粘接银胶	40W/mK超高导热率、良好导电性	10K	150°C 30mins
DA-5193	单组份银胶	高导电率、高Tg	8K-10K	150°C 30mins
DA-5195	单组份银胶	高导电率、高Tg、倒装晶片工艺、孔板刮胶专用	18K-23K	160°C 30mins
DA-518	单组份银胶	高导电率、高芯片推力	15K-20K	150°C 60mins
DA-518LV	单组份银胶	高导电率、高芯片推力、针对敏感基材	15K-20K	150°C 60mins

## 医疗仪器 Medical Equipment

### 主要应用

- 针头邦定
- 医疗面罩粘接
- 医疗用电极印刷



产品型号	描述	特性	粘度 cPs @25°C	固化条件
200-51	单组份环氧树脂	低温快速固化	12K-15K	100°C 30mins
UV-9014	透明触变性	UV固化、通过 USP Class 6 认证	4K-6K	600-800mJ/cm <sup>2</sup>
UV-9034	透明触变性	UV固化、通过 USP Class 6 认证	200-300	400-600mJ/cm <sup>2</sup>
CI-806	导电银浆	针对医疗电极产品、接触水凝胶和通电后不变色	<0.5Ω/□.mil	120°C 30mins
DI-7001	热固化防刮油、透明	保护医疗电极、不影响导电	--	130°C 20mins
CI-2062	可拉伸医疗电极碳浆	高延伸性，覆盖保护银线路	<50Ω/□.mil	90°C 5mins
CI-2067/77/79	电极碳浆	亲水性化学测试电极印刷	25Ω/□.mil	120°C 10mins
CI-401	氯化银医疗电极银浆	Ag/AgCl=55/45、药物注射应用	20K-25K	150°C 15mins
CI-4025	氯化银医疗电极银浆	Ag/AgCl=80/20、ECG/EEG 电极、血糖测试电极应用	15K-20K	150°C 15mins
CI-425	氯化银医疗电极银浆	Ag/AgCl=80/20、ECG/EEG 电极、血糖测试电极应用	15K-20K	150°C 15mins
CI-1036	可拉伸医疗电极银浆	适用于弹性PU布料基材	7K-15K	150°C 15mins
CI-4040	可拉伸氯化银医疗电极银浆	Ag/AgCl=80/20、适用于弹性PU布料基材	15K-20K	150°C 15mins

## 变压器粘合与灌封应用 Transformer Adhesion & Potting Applications

### 主要应用

● 电源/变压器 ● 点火线圈 ● 无线读卡机 ● 传感器 ● 桥式整流器



产品型号	描述	特性	混合后粘度 cPs @ 25°C	固化条件
400-34	单组份环氧树脂	低硬度、高韧性、灰色	150K-210K	120°C 120mins
400-34HF	单组份环氧树脂	400-34无卤版本、浅灰色	130K-170K	120°C 135mins
400-36	单组份环氧树脂	高粘贴强度磁芯胶	糊状	120°C 45mins
400-36LH	单组份环氧树脂	400-36无卤版本	60K-90K	120°C 45mins
2001A/H-1	双组份环氧灌封胶	UL 94V-0、室温固化	5K-8K	25°C 24hrs
2001A/H-15	双组份环氧灌封胶	高强度、耐高温	5K-8K	80°C 2hrs + 125°C 2hrs
2001A/H-16	双组份环氧灌封胶	UL 94V-0、加热固化、高强度	4K-6K	90°C 2hrs 或 100°C 1hrs
2001A-4/ 600-9B	双组份环氧粘合剂	低垂流、快速固化	20K-30K	25°C 60mins
2039A/B	双组份环氧灌封胶	低应力、高绝缘	3K-5K	25°C 24hrs 或 70°C 1-2hrs
2059A/H-1	双组份环氧灌封胶	UL 94V-0、白色版本2001A/H-1	6K-8K	25°C 24hrs
2059A/H-16	双组份环氧灌封胶	UL 94V-0、白色版本2001A/H-16	5K-7K	60°C 4hrs
400-64A/ Cat Gel	双组份环氧粘合剂	低垂流、低应力、加温固化	10K-20K	120°C 30mins + 150°C 30mins
400-64-1AFR /600-9B	双组份环氧灌封胶	UL 94V-0、2.5W/mK 高导热率、低热膨胀系数	60K-90K	25°C 16hrs 或 65°C 1hr
400-64-1AFR /601-23B	双组份环氧灌封胶	散热、加温固化	60K-80K	120°C 30-60mins
400-64-1AFR /Cat-Gel	双组份环氧灌封胶	散热、绝缘性高、低应力	20K-30K	100°C 3hrs 或 125°C 2hrs
505-40A/B	双组份环氧灌封胶	1:1 体积比、低粘度	2K-4K	25°C 12-16hrs
505-59A/B	双组份环氧灌封胶	1:1 体积比、低硬度、透明	800-1000	25°C 24hrs
505-82A/B	双组份环氧灌封胶	UL 94V-0、1:1 体积比	7K-8K	60°C 2hrs
703-18A/B	双组份环氧灌封胶	透明灌封	300-600	60°C 4hrs

## 蜂鸣器/微电机系统组装 Buzzer/MEMS Assembly

### 主要应用

● 蜂鸣器 / 微电机系统组装粘贴和密封



产品型号	描述	特性	粘度 cPs @ 25°C	固化条件
2001A/H-1	双组份环氧树脂	UL 94V-0	5K-8K(混合后)	25°C 24hrs
400-30	单组份环氧树脂	快速固化	20K-27K	120°C 30mins
400-97	单组份环氧树脂	流动性好	40K-60K	125°C 60mins
704-78	单组份环氧树脂	低温快速固化	20K-30K	120°C 20mins

## 结构胶及其他 Structural Adhesives and Others

### 主要应用

● 一般结构胶 ● 玻璃车头灯组装密封 ● LCD组装 ● 智能IC卡组装



产品型号	描述	特性	粘度 cPs @ 25°C	固化条件
282A/B	双组份环氧胶(灰色)	2W/mK 高导热率、1:1 混合比、双管针筒包装、使用方便	糊状	25°C 24hrs 或 65°C 2hrs
284A/B	双组份环氧胶(黑色)	2W/mK 高导热率、1:1 混合比、双管针筒包装、使用方便	80K-120K	25°C 24hrs 或 65°C 2hrs
286A/B	双组份环氧胶(白色)	2W/mK 高导热率、1:1 混合比、双管针筒包装、使用方便	糊状	25°C 24hrs 或 65°C 2hrs
503-98A/B	双组份环氧树脂	双管针筒装、极快干、透明	10K-15K(混合后)	25°C 6-20mins
480-01A/B	双组份环氧树脂	2:1双管针筒装、透明	15K-20K(混合后)	25°C 24hrs
480-02A/B	双组份环氧树脂	2:1双管针筒装、透明	1K-3K(混合后)	25°C 24hrs
480-03A/B	双组份环氧树脂	双管针筒装、快干、透明	15K-20K(混合后)	25°C 15-30mins
504-42	高温灯具粘接硅胶	耐高温250°C、投影机灯泡结构胶	接近糊状	150°C 60mins
703-60L	单组份环氧树脂	玻璃车头灯密封胶	200K-300K	120°C 30mins
Pacer RX 系列	氰基丙烯酸盐粘合剂	对金属、塑料都有良好附着力	多种粘度选择	常温瞬间固化
Pacer ANL 系列	螺纹固定胶	具可返修性	多种粘度选择	缺氧固化
EPOSOLVE 165	溶胶水	可溶解固化后的环氧胶	<500	--

## 微电子应用 Micro-electronic Material

### 主要应用

● 邦定盖封黑胶 ● 导热/密封胶 ● 底部填充IC封装

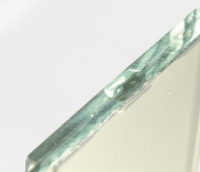


产品型号	描述	特性	粘度 cPs @ 25°C	固化条件
180-02	COB 邦定黑胶	低粘度	10K	120°C 30mins
400-97	COB 邦定黑胶	流动性好、胶身薄	40K-60K	125°C 60mins
408-14	COB 邦定黑胶	耐高温高湿、可通过回流焊	45K-55K	120°C 30mins
505-26	COB 邦定黑胶	孔板刮膠用、低厚度	60K-70K	110°C 30mins
EB-7408	COB 邦定黑胶	低温固化、储存稳定性好	40K-50K	120°C 30mins
EN-7830	高级COB 邦定黑胶	耐高温高湿、可通过PCT测试	65K-90K	150°C 30mins
DA-5100	芯片粘接银胶	高导电性、IC 芯片贴片专用	糊状	150°C 30mins
400-58	SMA表面贴片红胶	强粘力、瞬间固化	200K-250K	120°C 20mins
400-58HF	無卤SMA表面贴片红胶	强粘力、瞬间固化	250K-350K	120°C 20mins
500-71	防潮绝缘涂层	低温快速固化	50-100	60-70°C 2hrs
500-71-1	防潮绝缘涂层	可紫外光检视	50-100	60-70°C 2hrs

## UV胶 UV Adhesive

### 主要应用

● 玻璃 ● 金属 ● 塑胶粘接

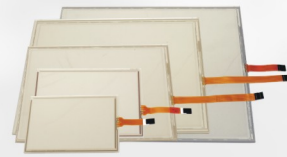


产品型号	描述	特性	粘度 cPs @ 25°C	固化条件
UV-108	高度透明	快速UV 固化	100K-300K	400-600 mJ/cm <sup>2</sup>
UV-108HV	FIP防水垫圈应用	不垂流、回弹性高	35K-45K	600-1000 mJ/cm <sup>2</sup>
UV-109	UV/烘烤 双固化胶	UV初固后加热可保证阴影位置全固化	15K-30K	600-800 mJ/cm <sup>2</sup> 或 120°C 30mins
UV-146	多基材UV结构胶	对玻璃、金属和塑胶附着力好, 低收缩	15K-30K	600-800 mJ/cm <sup>2</sup>
UV-147	防水封边胶	快速UV 固化	10K-20K	600-800 mJ/cm <sup>2</sup>
UV-148	UV转印胶	耐磨, 高硬度	10K-20K	600-800 mJ/cm <sup>2</sup>
UV-150	UV螺丝固定, 半透明蓝色	耐冷热冲击	7K-12K	395LED 800mJ/cm <sup>2</sup>
UV-151	高触变、PCB盖封	耐冷热冲击	20K-30K	365LED 800mJ/cm <sup>2</sup>
UV-152	数据线焊点保护, 透明	柔韧性好, 无卤	5K-9K	365LED 800mJ/cm <sup>2</sup>
UV-153	数据线焊点保护, 红色	柔韧性好, 无卤	20K-30K	365LED 800mJ/cm <sup>2</sup>

## 触摸屏 Touch Panel

### 主要应用

- 电极印刷
- 绝缘层印刷



产品型号	描述	特性	粘度 cPs @25°C	固化条件
CI-1016B	ITO基材用导电银浆	0.030Ω/□.mil、可激光蚀刻、表面硬度高、无卤素	25K-30K	140°C 45mins
CI-1035C	ITO基材用导电银浆	0.035Ω/□.mil、低价、附着力强、电阻屏用	60K-90K	130°C 30mins
CI-2045	ITO基材用导电碳浆	22Ω/□.mil、无卤素、低阻抗、ITO基材附着力高	100K-200K	120°C 30mins
CI-2046	ITO基材用导电碳浆	200Ω/□.mil、无卤素、深黑色	200K-400K	120°C 30mins
DI-511	ITO基材用可剥蓝胶	暂时性保护、容易剥离	35K-45K	130°C 10mins
D04-105	UV绝缘油	ITO用半透明绝缘油	40K-60K	900mJ/cm <sup>2</sup>
D04-228	UV绝缘油	ITO用半透明绝缘油、低气味	40K-60K	900mJ/cm <sup>2</sup>
D04-197	UV绝缘油	ITO用高透明绝缘油、隔点油	5K-7K	900mJ/cm <sup>2</sup>
DI-701C	热固化绝缘油、透明	ITO基材附着力高、不影响银浆导电性	>800V/mil	130°C 20mins

## 电机/步进马达装配 Motor/ Stepper Motor Assembly

### 主要应用

- 永磁电机磁片粘接
- 转轴线圈保护颈胶
- 碳刷/换相器粘接

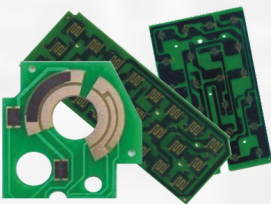


产品型号	描述	特性	粘度 cPs @25°C	固化条件
180-08A/B	步进马达轴心密封胶	耐高温、绿色	50K-70K(混合后)	150°C 120mins
280-01A/B	无刷电机定子灌封胶	1.5W/mK高导热率、低应力	30K-50K(混合后)	25°C 24hrs
400-36G	单组份步进马达轴心密封胶	耐高温、绿色	180K-230K	120°C 30mins
400-36LV	单组份步进马达轴心密封胶	耐高温、灰色	150K-200K	120°C 30mins
400-76-1	磁铁粘接环氧胶	超低粘度	80K	120°C 45mins
480-02A/B	双组份磁铁粘接胶	2:1双管针筒装、透明	1K-3K(混合后)	25°C 24hrs
505-96	电机转子颈胶	超耐高温、高Tg 220°C	糊状	160°C 30mins
506-12	电机钕铁硼磁铁粘接	对钕铁硼粘接强度高	糊状	140°C 45mins 加 160°C 60mins
702-80	电机转子颈胶	耐高温、抗腐蚀	糊状	120°C 30mins
702-80-140K	电机转子颈胶	耐高温、抗腐蚀、低粘度	140K	120°C 30mins
702-98	磁铁粘接环氧胶	高速电感固化	糊状	电感固化 或 120°C 40mins
DA-5193	换相器导电银胶	对铜和石墨片有良好的粘合力	8K-10K	150°C 30mins
P-2T/SC	磁铁粘接结构丙烯酸	强粘力	48K	25°C <1min

## 线路板触点与线路印刷 Circuitry and Contacts Printing

### 主要应用

- 一般硬板线路印刷
- 可变电阻印刷
- 碳灌孔底面导通

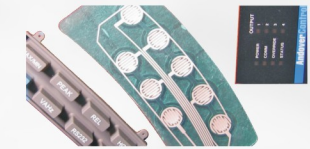


产品型号	描述	特性	电性	固化条件
CI-2015S	热固性碳浆	耐磨、低电阻、高粘度	13Ω/□.mil	150°C 30mins
CI-2015H	热固性碳浆	耐磨、高导电率、高粘度、可用作灌孔	22Ω/□.mil	150°C 30mins
CI-2015L	热固性碳浆	低粘度、配合CI-2015H使用	22Ω/□.mil	150°C 30mins
CI-2015XL	电阻调节碳浆	超低粘度、配合其他CI-2015使用	(不可单独使用)	--
CI-2015T	热固性碳浆	可变电阻用高阻碳浆系列	10K, 100K, 1MΩ/□.mil	150°C 30mins
DI-529B	高温可剥蓝胶	耐高温260°C、暂时性保护、容易剥离	--	150°C 30mins
DI-529G	高温可剥绿胶	耐高温260°C、暂时性保护、容易剥离	--	150°C 30mins
DI-529R	高温可剥红胶	耐高温260°C、暂时性保护、容易剥离	--	150°C 30mins

## 软性线路 / 薄膜开关 Membrane switch / FPC / RFID

### 主要应用

- 软性线路印刷
- 薄膜开关应用
- RFID射频天线印刷



产品型号	描述	特性	电性	固化条件 (烤箱)
CI-800	导电银浆	高导电率、耐弯折、附着力好	<0.015Ω/□.mil	120°C 30mins
CI-801	导电银浆	超高导电率、细线印刷	<0.009Ω/□.mil	130°C 30mins
CI-802	导电银浆	低温固化	<0.018Ω/□.mil	90°C 30mins
CI-804	导电银浆	针对敏感基材、例如PC料	<0.010Ω/□.mil	120°C 30mins
CI-805	导电银浆	针对敏感基材、低银含	<0.010Ω/□.mil	120°C 30mins
CI-1001	导电银浆	高导电率	<0.015Ω/□.mil	120°C 20mins
CI-1001B	导电银浆	高导电率、低价版	<0.015Ω/□.mil	120°C 20mins
CI-1036	导电银浆	高导电率、高延伸性	<0.010Ω/□.mil	110°C 20mins
CI-2001	导电碳浆	耐磨、保护银线路触点	<20Ω/□.mil	110°C 20mins
CI-2001XL	导电碳浆	低粘度、与CI-2001配合使用	(不可单独使用)	110°C 20mins
CI-2018	导电碳浆	斑马纸应用、印刷线路精细	<12Ω/□.mil	120°C 30mins
CI-2018H	导电碳浆	高粘度、低阻抗、印刷线路用	<11Ω/□.mil	120°C 30mins
CI-2018L	导电碳浆	低粘度、与CI-2018H配合使用	<50Ω/□.mil	120°C 30mins
CI-2018S	导电碳浆	超低电阻、印刷线路用	<8Ω/□.mil	120°C 30mins
CI-2002	电热碳浆	电热毯用、耐高温	<50Ω/□.mil	110°C 20mins
CI-2022	电热碳浆	高阻值、与CI-2002 配合使用	<20KΩ/□.mil	110°C 20mins
CI-2050	导电碳浆	压力感应碳浆	<20KΩ/□.mil	110°C 10mins
CI-2050HR	导电碳浆	压力感应、与CI-2050 配合使用	(不可单独使用)	110°C 10mins
CI-2068	电热碳浆	PTC温度感应	11KΩ/□.mil@25C	120°C 10mins
CB-F1023	导电碳浆	LCD ITO 层导通用	<15Ω/□.mil	80°C 15mins
DI-701	热固化绝缘油、绿色	一般应用、低价版	>800V/mil	130°C 20mins
DI-701C	热固化绝缘油、透明	ITO基材附着力高、不影响银浆导电性	>800V/mil	130°C 20mins
DI-702	UV固化绝缘油	一般应用、低价版	>800V/mil	750mJ/cm <sup>2</sup>
DI-702C	UV固化绝缘油	一般应用、半透明	>800V/mil	750mJ/cm <sup>2</sup>
DI-703	UV固化绝缘油	LEDUV固化	>800V/mil	750mJ/cm <sup>2</sup>
DI-7502	UV固化绝缘油	抗对折性好	>800V/mil	750mJ/cm <sup>2</sup>
DI-7502B	UV固化绝缘油	蓝色版本	>800V/mil	750mJ/cm <sup>2</sup>
DI-7502C	UV固化绝缘油	透明版本	>800V/mil	750mJ/cm <sup>2</sup>
DI-7502LH	UV固化绝缘油	无卤素、浅绿色版本	>800V/mil	750mJ/cm <sup>2</sup>
DI-7544	UV固化绝缘油	耐高温高湿	>800V/mil	750mJ/cm <sup>2</sup>
D04-132	UV固化隔点油	高厚度、作隔层油用	>800V/mil	750mJ/cm <sup>2</sup>
DA-5100	LED灯贴片银胶	高附着力	<0.0006Ω.cm	130°C 90mins
EC-9519	LED灯盖封透镜胶	UV固化、低应力、低硬度50D	>800V/mil	750mJ/cm <sup>2</sup>